

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成31年1月17日 (2019.1.17)

【公開番号】特開2017-220543(P2017-220543A)
 【公開日】平成29年12月14日 (2017.12.14)
 【年通号数】公開・登録公報2017-048
 【出願番号】特願2016-113277(P2016-113277)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 23/12 (2006.01)

H 0 5 K 3/46 (2006.01)

【 F I 】

H 0 1 L 23/12 5 0 1 B

H 0 5 K 3/46 B

H 0 5 K 3/46 N

H 0 5 K 3/46 T

【手続補正書】
 【提出日】平成30年11月29日 (2018.11.29)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 0 5 0
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【 0 0 5 0 】

次に、図 3 (a) に示す工程では、絶縁層 1 1 の一方の面 1 1 a に、配線層 1 4 を被覆するように絶縁層 1 5 を形成する。絶縁層 1 5 の材料としては、例えば、フェノール系樹脂やポリイミド系樹脂等を主成分とする絶縁性の感光性樹脂を用いることができる。絶縁層 1 5 の厚さは、例えば 5 ~ 1 0 μ m 程度とすることができる。絶縁層 1 5 は、シリカやアルミナ等のフィラーを含有しても構わない。絶縁層 1 5 の材料として、液状又はペースト状の樹脂を用いた場合には、配線層 1 4 を被覆するように絶縁層 1 1 の一方の面 1 1 a に液状又はペースト状の樹脂をスピンコート法等により塗布する。絶縁層 1 5 の材料として、フィルム状の樹脂を用いた場合には、配線層 1 4 を被覆するように絶縁層 1 1 の一方の面 1 1 a にフィルム状の樹脂をラミネートする。